



# 京鼎精密科技股份有限公司

## 2024第四季法人說明會

2025/03/13

# 免責聲明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息內，含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。

# 會議議程

- 公司簡介
- 財務報告
- 營運與展望
- 問答交流

李貞誼

發言人

鄒永芳

財務長

鄒永芳

財務長

李貞誼

發言人

黃俊凱

協理

徐朝煌

協理



# 公司簡介



劉揚偉

董事長

邱耀銓

執行長

## 主要業務

- 半導體前段製程設備關鍵模組及零部件製造服務
- 半導體設備及零部件再生循環
- 半導體自動化設備之研發、製造及銷售並提供整合性解決方案
- 醫療設備製造及設計服務

## 全球佈局 區域製造



2001  
成立

2015  
上市(3413TT)

3,543 員工人數  
截至2025/02/28

NT\$ 10.60億 股本  
截至2024/12/31

NT\$ 343.44億 市值  
截至2025/02/27

2024年合併營收  
NT\$164.54億  
+26.1% YoY

2024年營業毛利  
NT\$42.88億  
+25.6% YoY

2024年每股盈餘  
NT\$ 25.22元  
+23.1% YoY

# 全球佈局



量產基地：現有6座廠區，泰國春武里廠預計2025年完工

新產品開發中心



# 財務報告

# 綜合損益表



單位：新台幣百萬元	4Q24		3Q24		QoQ%	4Q23		YoY%	2024		2023		YoY%
營業收入淨額	4,799	100.0%	4,612	100.0%	4.1%	3,379	100.0%	42.0%	16,454	100.0%	13,051	100.0%	26.1%
營業毛利	1,228	25.6%	1,234	26.8%	-1.2 pts	927	27.4%	-1.8 pts	4,288	26.1%	3,415	26.2%	-0.1 pts
營業費用	(463)	(9.6%)	(424)	(9.1%)		(348)	(10.3%)		(1,626)	(9.9%)	(1,385)	(10.6%)	
營業利益	765	16.0%	810	17.7%	-1.7 pts	579	17.1%	-1.1 pts	2,662	16.2%	2,030	15.6%	+0.6 pts
營業外損益	250	5.1%	(102)	(2.2%)		76	2.3%		553	3.3%	482	3.7%	
稅前淨利	1,015	21.1%	708	15.5%	+5.6 pts	655	19.4%	+1.7 pts	3,216	19.5%	2,512	19.3%	+0.2 pts
本期淨利	789	16.4%	582	12.6%	+3.8 pts	506	15.0%	+1.4 pts	2,613	15.9%	1,990	15.3%	+0.6 pts
歸屬予：													
母公司股東	789		582		35.6%	506		55.9%	2,613		1,990		31.3%
基本每股盈餘(元)	7.43		5.52		1.91	5.19		2.24	25.22		20.48		4.74
加權平均流通在外股數(百萬股)	106.15		105.42			97.33			103.61		97.19		

# 資產負債表及重要財務指標



單位：新台幣百萬元

	4Q24		3Q24		4Q23	
現金及流動金融資產	10,206	44%	9,613	45%	10,583	55%
應收帳款	1,695	7%	1,703	8%	783	4%
存貨	3,888	17%	3,449	16%	2,620	14%
長期投資	497	2%	440	2%	417	2%
不動產、廠房及設備	5,186	22%	5,012	24%	3,781	20%
<b>資產總計</b>	<b>23,129</b>	<b>100%</b>	<b>21,506</b>	<b>100%</b>	<b>19,370</b>	<b>100%</b>
應付帳款	1,712	7%	1,533	7%	941	5%
銀行借款	1,760	8%	1,782	8%	1,671	9%
應付公司債	324	1%	586	3%	1,865	10%
流動負債	5,549	24%	4,622	21%	3,536	18%
<b>負債總計</b>	<b>7,921</b>	<b>34%</b>	<b>7,333</b>	<b>34%</b>	<b>7,768</b>	<b>40%</b>
<b>股東權益總計</b>	<b>15,208</b>	<b>66%</b>	<b>14,172</b>	<b>66%</b>	<b>11,602</b>	<b>60%</b>
<b>重要財務指標</b>						
平均收現天數	28		29		25	
平均銷貨天數	101		100		125	
平均付現天數	40		39		45	
淨營運現金週期天數	89		90		105	
流動比率(倍)	2.91		3.26		4.05	

# 現金流量表



單位：新台幣百萬元	2024	2023
期初現金	6,956	8,544
營運活動之現金(流出)流入	2,175	2,641
資本支出	(1,923)	(545)
現金股利	(1,173)	(1,340)
定期存款	987	(2,359)
銀行借款淨變動	88	(271)
投資與其他	417	286
期末現金	7,527	6,956
自由現金流量*	252	2,096

\*自由現金流量=營運活動之現金流入-資本支出

# 穩定的股利政策



註1：2024年股利發放金額待2025/5/28股東會承認通過

註2：股票殖利率之股價以董事會公告股利政策當日之收盤價計算

# 營運與展望

# 營收趨勢

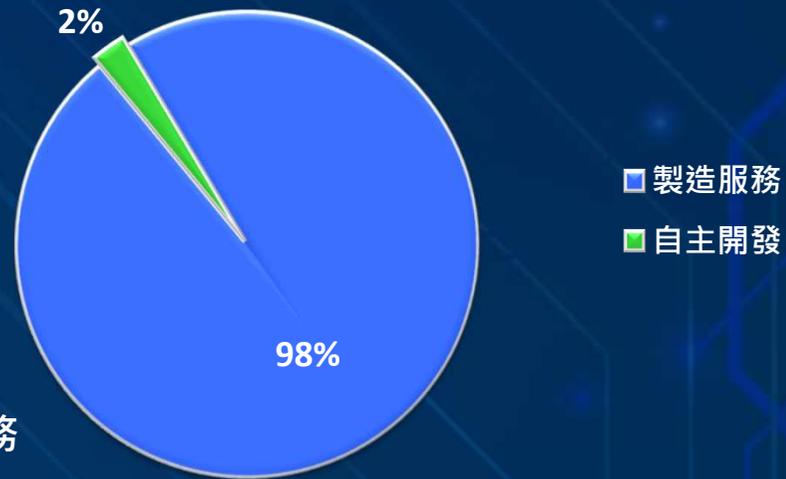


- Q4營收**47.99**億 QoQ **+4.1%** YoY **+42%**，連續三季成長，創單季新高。
- 2024年營收**164.54**億 YoY **+26.1%**，再創歷史新高



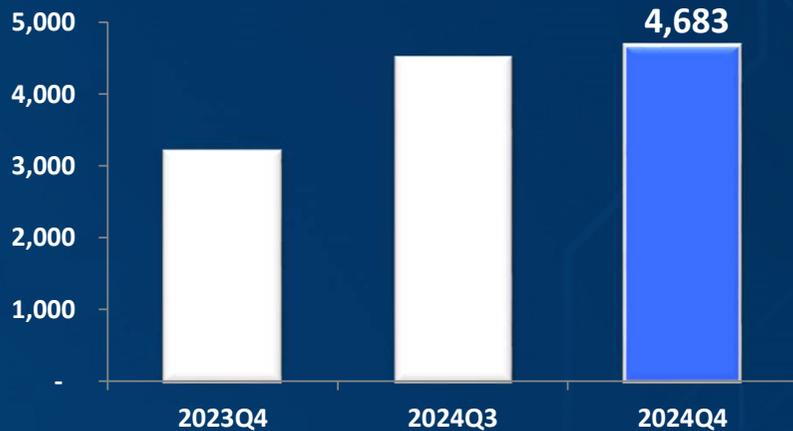
註：製造服務=半導體/面板設備關鍵部件製造+能源設備關鍵部件製造；自主開發=自動化設備

# 2024年第四季銷售分析-業務別



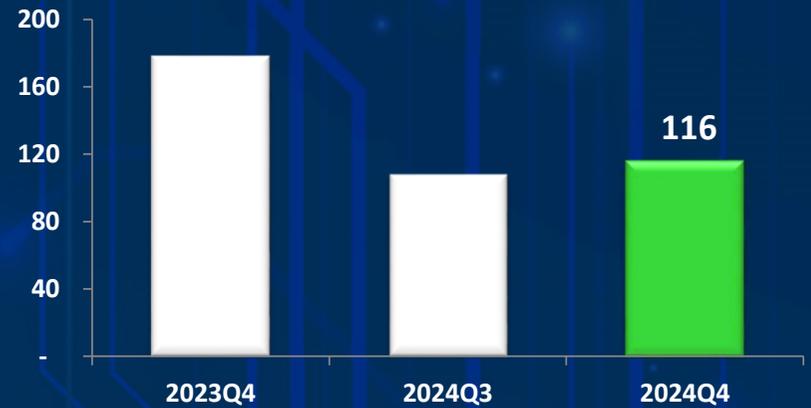
單位：台幣百萬

**製造服務**  
**+4.0% QoQ**  
**+46.3% YoY**



單位：台幣百萬

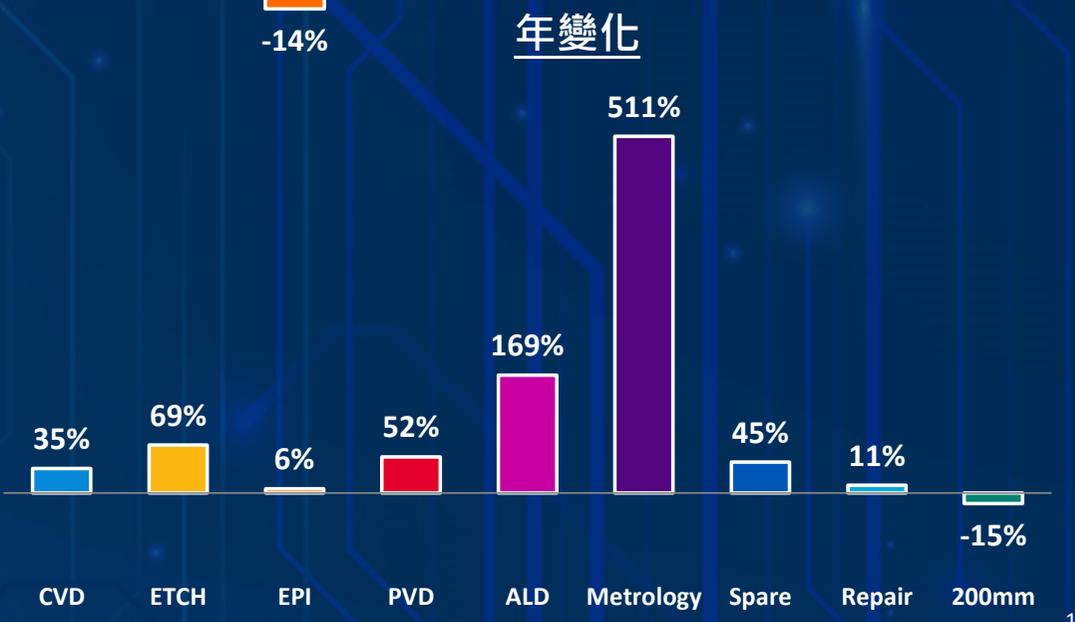
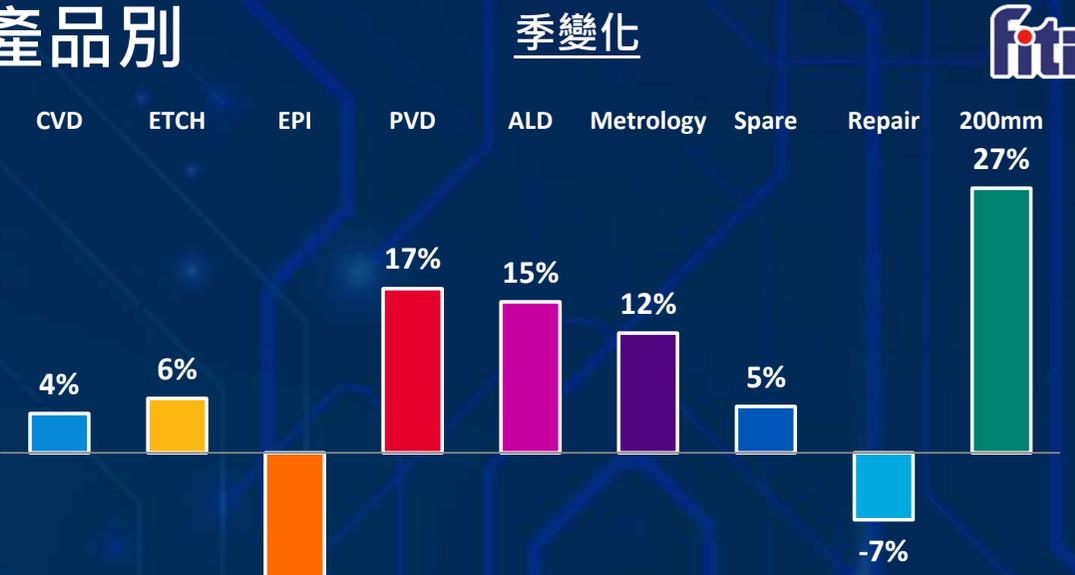
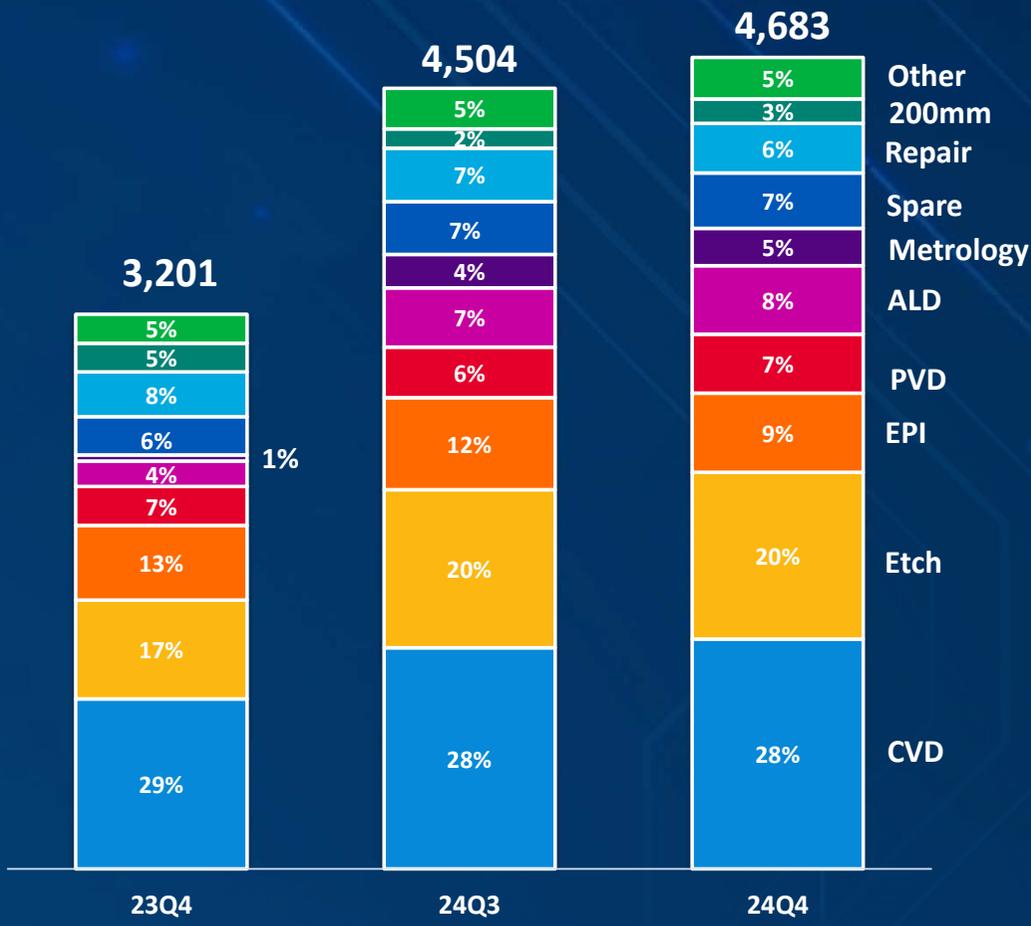
**自主開發**  
**+7.7% QoQ**  
**-34.6% YoY**



# 2024年第四季製造服務銷售分析-產品別



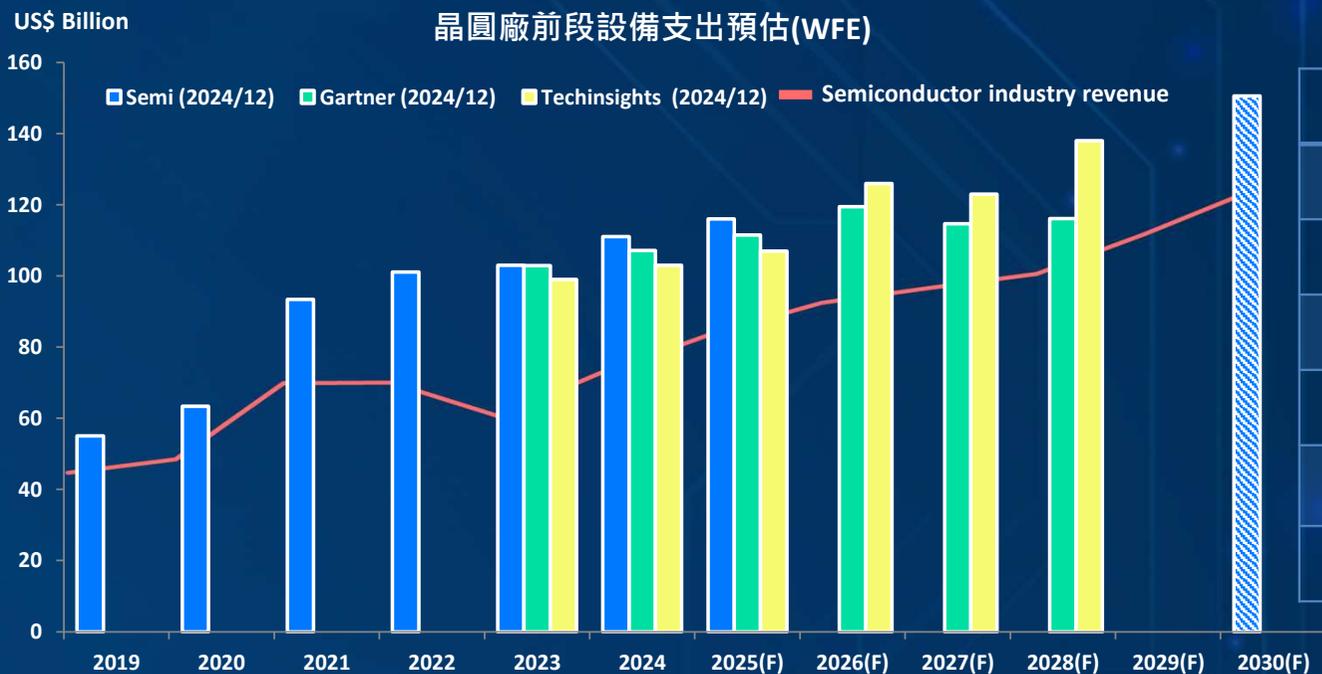
單位：台幣百萬



# 產業趨勢



- 2025年WFE市場預計小幅成長4%-5%，主要受AI/HPC應用帶動，推動先進製程(GAA、BPD)技術導入、HBM需求成長，以及先進封裝技術發展，帶動半導體設備投資增加。
- 展望2026年，WFE市場成長動能可望延續，預計年增7%-18%。隨著AI/HPC需求持續成長，先進邏輯與記憶體技術持續升級，晶片結構日趨複雜、製程精細度要求提升，進一步帶動蝕刻、薄膜沉積及檢測設備需求成長。
- 新興應用持續推動半導體需求成長與矽含量提升，製程技術日益複雜，加上地緣政治驅動供應鏈自主化，將推動半導體設備市場的長期成長。



WFE(\$B)	2024	2025(F)	2026(F)	2027(F)	2028(F)
Semi (2024/12)	111	116			
YoY	8%	5%			
Gartner (2024/12)	107	112	119	115	116
YoY	4%	4%	7%	-4%	1%
TechInsights (2024/12)	103	107	126	123	138
YoY	4%	4%	18%	-2%	12%

Source:Semi/Gartner/TechInsights

# 2025年第一季展望



# 獲獎榮耀

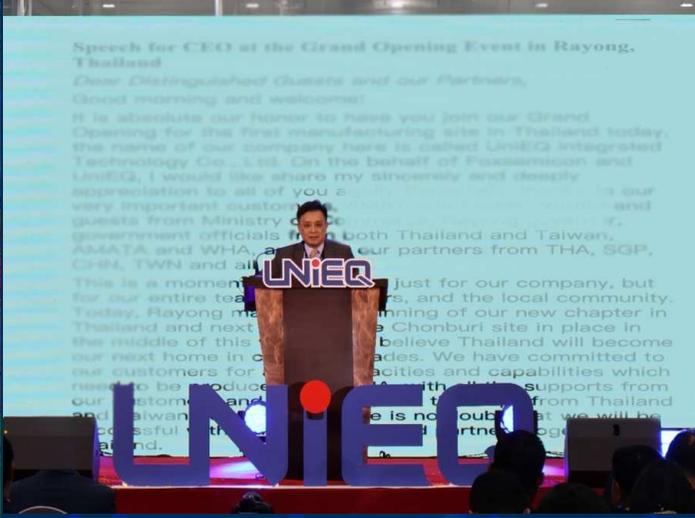


應用材料  
傑出供應商獎-  
卓越表現



ASM  
傑出供應商獎

# 羅勇廠正式開幕 – 2025/1/16



# 總結

- 2024年營運登峰，2022-2024連續三年每年賺二個股本以上
  - 2024年營收、獲利、股利全面改寫歷史新高
- 2025年營運樂觀，表現將優於市場
  - AI 與 HPC 持續推動先進製程發展，帶動半導體設備投資擴大，預期 2025-2026 WFE市場將持續成長。
  - 各國積極建立半導體自主供應鏈，加速晶圓廠設立與產能擴充，進一步推升備品耗材與維修服務需求。
  - 先進邏輯與記憶體技術不斷升級，加上晶片結構日趨複雜，推動蝕刻、薄膜沉積及檢測設備需求增加。
  - 泰國羅勇廠於Q1提前投產，降低地緣政治風險並提升垂直整合製造能力，強化市場競爭力，進而推動營收成長。
  - AI 與 HPC 帶動穩健訂單需求，Q1 營收可望與前一季持平，預期將創同期新高。

# Q&A



# Thank you